



Für Gamer und kreative Profis: Sonnet stellt portable Grafikkarten-Boxen für Ultrabooks vor

Die neuen eGFX Breakaway™ Puck Radeon™ RX 560 und RX 570 GPU bieten vier Video-Ausgänge und Thunderbolt 3-Interface

Irvine, Kalifornien, im November 2017 – Mit den extrem leistungsstarken und handlichen Grafikkarten-Gehäusen der Serie eGFX Breakaway™ Puck ermöglicht Sonnet Technologies jetzt auch die Anbindung von externen GPU-Geräten an Computern mit Thunderbolt 3. Anwender kommen damit in den Genuss von Grafikanwendungen und Multidisplay-Verbindungen mit AMDs Eyefinity™ Technologie. Mit dem Puck profitieren Gamer bei grafikintensiven Spielen von einer deutlichen Steigerung der Bildfrequenzraten und kreative Profis von der GPU-Beschleunigung, beispielsweise bei Video-Workflows.

Sonnet bietet den Puck in zwei Ausführungen an. Anwender können zwischen dem eGFX Breakaway Puck Radeon™ RX 560 und dem eGFX Breakaway Puck Radeon RX 570 wählen. Die handlichen Grafik-Boxen sind jeweils sechs Zoll breit, 5,1 Zoll tief und 2 Zoll hoch und können daher unkompliziert zusammen mit dem Notebook in der Laptop-Tasche oder im Rucksack verstaut werden. Sie sind mit je einem Thunderbolt 3-Port, drei Display-Ports und einem HDMI-Port ausgestattet. Im Multimonitor-Modus werden bis zu vier 4K-Monitore unterstützt.

Der Puck wird einfach per Thunderbolt 3-Kabel an den Computer angeschlossen. Er bringt eine zusätzliche Stromversorgung von 45 Watt mit, über die der angeschlossene Computer bequem geladen werden kann – das Ladegerät des Laptops kann somit Zuhause bleiben. Der Puck benötigt nur wenig Platz am Desktop. Mit einem optional erhältlichen VESA-Befestigungsset kann er auch platzsparend auf der Rückseite des Monitors oder an einem Multimonitor-Ständer

angebracht werden. Ein Display Port Kabel von einem halben Meter Länge ist im Lieferumfang enthalten.

Die Geräte sind ab sofort verfügbar, eGFX Breakaway Puck Radeon RX 560 (Artikelnummer GPU-RX560-TB3) zum UVP von 609 Euro, eGFX Breakaway Puck Radeon RX 570 (Artikelnummer GPU-RX570-TB3) zum UVP von 809 Euro, das PuckCuff VESA-Befestigungsset (Artikelnummer CUFF-PUCK) zum UVP von 65 Euro. Alle Preise sind inklusive gesetzlicher MwSt.

Weitere Informationen zu diesem Produkt können unter folgendem Link abgerufen werden:

www.sonnettech.com/product/egfx-breakaway-puck.html.

Weitere Informationen zu Sonnet: <http://www.sonnettech.com/de>

###

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafik (eGFX)-Lösungen für professionelle Anwender und Gamer, Docks und Adaptern sowie Interface-Karten und Media-Lesegeräten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt-Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen Anwendern den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, Grafikkarten, Interface-Karten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an MacBooks, Laptops sowie an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an hochleistungsfähigen, kostengünstigen und zuverlässigen mobilen, Desktop- und Rackmount-Speicherlösungen. Seit 30 Jahren entwickelt und produziert Sonnet innovative, preisgekrönte Produkte, mit denen die Leistung sowie die Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert werden. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Pressekontakt:

Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 949 697 08 1

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil Marketing

Public Relations

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

Fax +49 (0)89 22 13 94

a.weinholz@profil-marketing.com